

湾芯展

SEMIBAY 2024

芯动未来 共创生态

CHIP DRIVES THE FUTURE, COLLABORATION
CREATES THE ECOSYSTEM

2024.10.16-18

深圳会展中心(福田)

湾区半导体
产业生态博览会

SEMIBAY
SEMICONDUCTOR
ECOSYSTEM EXPO



立刻扫码预登记



填表提交参展意向

40000 m²

展出面积

300+

参展企业

30000+

专业观众

20+

专业论坛

指导单位：深圳市人民政府

主办单位：深圳市发展和改革委员会、深圳市龙岗区人民政府

承办单位：深圳市半导体与集成电路产业联盟SICA、深圳市重大产业投资集团有限公司

支持单位：中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司、华润微电子有限公司、深圳方正微电子有限公司、深圳市鹏芯微集成电路制造有限公司、深圳市昇维旭技术有限公司、深圳市鹏新旭技术有限公司、安谋科技(中国)有限公司、芯谋市场信息咨询(上海)有限公司、广东省大湾区集成电路与系统应用研究院、中国集成电路零部件创新联盟

展会介绍 INTRODUCTION

湾芯展SEMIBAY旨在贯彻落实深圳“20+8”产业“一集群、一展会”决策部署，由深圳市人民政府指导、深圳市发展与改革委员会和深圳市半导体与集成电路产业联盟（深芯盟）主办，充分依托深圳及大湾区的广阔应用市场，以及深重投主导的重大产业项目集群等优质资源，聚焦半导体设备、材料、晶圆制造、封测、设计和应用等重点领域。

湾芯展SEMIBAY旨在推动半导体产业链协作共赢，从产业生态、技术生态、资本生态、人才生态四个维度构建中国半导体的健康发展生态体系，搭建起能够促进国内外半导体产业链、供应链和价值链深度融合的交流与合作平台。



中国是全球最大的半导体市场，湾区是中国最大的半导体增量市场；



深圳是全球最重要的IC设计和应用市场，未来也将成为最重要的晶圆制造集群；



未来10年，湾区对半导体设备和材料的采购总额逾万亿，为国产厂商带来巨大商机；



湾芯展可助您深度对接重大半导体项目资源和产业基金，促成现场洽谈及交流合作；



展会汇聚最新半导体技术、产品和创新方案，为您提供一站式采购和交流平台。

展览专区 EXHIBITION ZONE

1 晶圆制造展区



晶圆加工设备及厂房设备
晶圆加工材料
子系统、零部件和间接耗材
晶圆加工(Foundry)、IDM及设计公司

2 封装测试展区



测试封装设备
测试封装材料
子系统、零部件和间接耗材
封装测试厂(OSAT)

3 化合物半导体展区



碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、
砷化镓(GaAs)材料
射频(RF)、大功率半导体、
新能源功率器件

4 零部件展区



工艺零部件、结构零部件、模组、气体管路、
射频电源、光学类、真空系统类、传感器类、
仪器仪表类等种类

5 EDA/IP与设计服务展区



电子设计自动化(EDA)软件和服务
工艺控制/工艺软件
芯片设计IP和服务
Chiplet设计和咨询服务
2.5D/3D先进封装设计和咨询服务
AI和云端设计平台及服务
其他设计服务

6 汽车半导体展区



IGBT、碳化硅和氮化镓等车规级功率半导体
车规级MCU、ECU和域控制器
智能座舱/ADAS/自动驾驶芯片和系统
车规级存储器和高性能计算芯片(AI/GPU/CPU)
汽车安全和车联网芯片、模组和系统

湾芯展

SEMIBAY 2024

SEMIBAY

Reports 产业分析报告

SEMIBAY

Awards 奖项

SEMIBAY

Competition 大赛

SEMIBAY

Rankings 榜单

SEMIBAY

Conference 湾区半导体大会

SEMIBAY

Conference 湾区半导体大会

A

Summit
高峰论坛

B

Tech Forum
技术论坛

C

Academy Forum
院(校)长论坛

20+场专业领域的垂直论坛，主题涉及晶圆制造工艺、先进材料、Chiplet与先进封装、化合物半导体、封装与测试、EDA/IP、IC设计等领域的技术和应用创新，以及AI、5G、物联网、汽车智能化和电动化、新能源等新兴应用对半导体产业的挑战和机遇。

B

技术论坛 Tech Forum

- 先进封装工艺与材料论坛
- Chiplet与先进封装论坛
- 晶圆制造工艺与管理创新论坛
- 国际半导体设备技术与工艺论坛
- 国际化合物半导体产业发展论坛
- 碳化硅(SiC)与汽车半导体技术与应用论坛
- 半导体激光与光电芯片技术论坛
- AI芯片与高性能计算(HPC)应用论坛
- 半导体产业投融资发展论坛
- 院校长论坛
- EDA/IP与IC设计论坛
- 集成电路材料创新峰会
- RISC-V生态发展峰会
- HBM与存储器技术和应用论坛
- 新能源汽车 800V 高压系统与功率半导体技术大会
- 边缘计算芯片技术创新发展论坛
- 智能网联汽车创新发展论坛暨第22期大湾区汽车创新论坛
- 2024中国(深圳)半导体与传感器技术发展论坛
- 2024深圳显示芯片生态论坛
- 半导体核心零部件创新发展论坛

展馆示意图

EXHIBITION HALL DIAGRAM



晶圆制造展区



零部件展区



封装测试展区



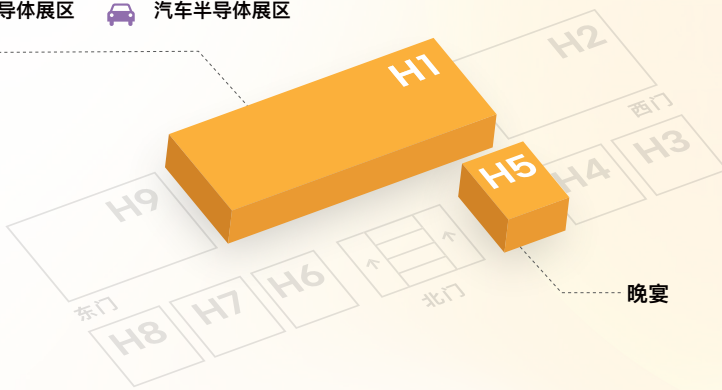
EDA/IP与设计服务展区



化合物半导体展区



汽车半导体展区



VIP专业买家 (不断增加中)

- **晶圆制造厂商:**
中芯国际、方正微、华润微、鹏芯微、鹏新旭、昇维旭
- **封装测试厂商:**
长电科技、通富微电、华天科技、沛顿科技、江波龙、深圳佰维、天微电子、赛意法微电子、时创意电子、盛元半导体、气派科技
- **IC设计公司:**
华为海思、中兴微电子、国民技术、汇顶科技、芯海科技、云天励飞、深圳中微、南方硅谷、必易微、思睿达、芯茂微、英集芯、极海半导体、康佳、TCL
- **功率半导体厂商:**
英飞凌、ST、安森美、比亚迪半导体、华润微电子、中车电气、扬杰电子、英诺赛科、瑞能半导体、华微电子、固锟电子、基本半导体、安世、士兰微
- **新能源汽车厂商:**
比亚迪、一汽、小米、华为、中汽研科技、吉利、特斯拉、蔚来、理想、小鹏、广汽、长城、哪吒、赛力斯、上汽、北汽、宁德时代、博世

知名参展企业一览 *排名不分先后



支持单位

中国汽车芯片标准检测认证联盟、第三代半导体产业技术创新战略联盟、广东省集成电路行业协会、求是缘半导体联盟、湖北省半导体行业协会、广东省半导体光源产业协会、中国智慧城市建设投资联盟、广东省大湾区新能源汽车产业技术创新联盟、广东中科半导体微纳制造技术研究院、深圳市存储器行业协会、深圳市宝安区半导体行业协会、深圳市半导体产业发展促进会、深圳市芯片科技促进会、东莞市集成电路行业协会、广州市电子行业协会、横琴粤澳深度合作区半导体行业协会、广州第三代半导体创新中心、深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会、广东省湖北商会电子专业委员会、深圳市南山智慧园区运营服务有限公司、深圳福田新一代智慧运营服务有限公司、深圳市坪安智慧园区运营管理服务有限公司、深圳市坪山区产业投资服务有限公司、深圳市中电智谷运营有限公司、深圳市赢城产业运营有限公司、深圳市产业空间发展有限公司、天安云谷、乐荟中心、湾区芯谷、南沙资讯科技园、深圳市智汇科技产业促进中心有限公司

参展费用 EXPENSES

标准展位

2500 RMB/m² 12m² 起租

设备包括
 ✓ 三面展板 ✓ 一桌两椅 ✓ 门楣 ✓ 灯具
 ✓ 电源插座 ✓ 一个圆桌 ✓ 地毯
 (特殊用电须向展馆申请, 另行收费)

特装展位

2300 RMB/m² 36m² 起租

! 不配备任何设施



深圳市半导体与集成电路产业联盟 (SICA)

芯盟会展有限公司

参展联系 张建Ken Tel: 135-1025-6927
 E-mail: ken.zhang@semibay.cn

市场合作 林一贤 Ivy Tel: 134-3049-7244
 E-mail: ivy@semibay.cn

VIP特邀+ 周镇权 Thomson Tel: 189-2414-7673
 买家组团 E-mail: thomson.zhou@semibay.cn